

7 その他欠陥

其它的缺陷 / Other defects

回路欠陥

S R 欠陥

シンボルマーク欠陥

めっき欠陥

スルーホール欠陥

機械加工欠陥

その他欠陥

信頼性不足

はんだ上がり欠陥

電子部品装はんだ周の欠陥

7-1 積層欠陥 / 层压的缺陷 / Lamination defects

7-1-1 層間ズレ / 层间偏移 / Layer-to-layer misalignment

【特徴】 外層と内層の相関ズレが仕様を満たしていない状態の欠陥

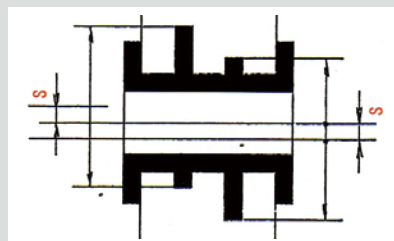
【特征】 外层与内层相互偏移，不满足标准的缺陷。

【Characteristics】 Alignment of an outer layer to an inner layer does not meet the specification.

【起因・判断ポイント・発生工程】 各層パターンの出来上がり精度のバラツキや、各層相互の位置合わせ精度のバラツキ、積層時の横滑りなどにより出来たもの（積層工程）

【原因、判断要点、発生工序】 各层图形的完成精度不一致、各层的对位精度不一致、层压时横向滑动等所引起的（层压工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】
The defect is caused by layer-to-layer variation in finished dimensions of formed conductive patterns, variation in layer-to-layer registration or laminate slipping in lamination (Lamination process)



【コメント】
上図の S 寸法が仕様を満たさないもの

【注釋】
上图的 S 尺寸不满足标准。

【Comments】
S: out of specification

7-1-2 基板積層ボイド / 层压板有空洞 / Void in laminate

【特徴】 多層板の中に、白っぽい空洞が見られる状態の欠陥

【特征】 在多层板上可见偏白的空洞的缺陷。

【Characteristics】 There is a whitish laminate void in a multilayer board.



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×